

Vogt AG Verbindungstechnik creating connections



SMD SORTIMENT

Kontaktfedern

Schraubbefestigungen

Lötbrücken




Sicherungshalter

Steckzungen

SMD Kontaktfedern

	Artikel	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verpackungseinheit
	400.20	SMD Kontaktfedern	Berylliumkupfer	blank	Beutel (à 250 Stk.)
	400.22	SMD Kontaktfedern	Berylliumkupfer	vergoldet	Beutel (à 250 Stk.)
	400.80	SMD Kontaktfedern	rostfreier Stahl	blank	Beutel (à 250 Stk.)
	400.82	SMD Kontaktfedern	rostfreier Stahl	vergoldet	Beutel (à 250 Stk.)



SMD Schraubbefestigungen

	Artikel	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verpackungseinheit
	408.60	SMD Schraubbefestigung	Messing	blank	Beutel (à 500 Stk.)
	408.68	SMD Schraubbefestigung	Messing	reinverzinkt	Beutel (à 500 Stk.)
	408068	SMD Schraubbefestigung	Messing	reinverzinkt	gegurtert (à 500 Stk.)

SMD Lötbrücke

Artikel	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verpackungseinheit
 410.48	SMD Lötbrücke	Kupfer	reinverzinnt	Beutel (à 250 Stk.)

SMD Sicherungshalter

Artikel	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verpackungseinheit
 420.28	SMD Sicherungshalter	Bronze	reinverzinnt	Beutel (à 1'000 Stk.)
 4200.28	SMD Sicherungshalter	Bronze	reinverzinnt	gegurtet (à 1'000 Stk.)

SMD Steckzungen

Artikel	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche	Verpackungseinheit
 450.60	SMD Steckzungen	Messing	blank	Beutel (à 500 Stk.)
 450.64	SMD Steckzungen	Messing	verzinkt reflow	Beutel (à 500 Stk.)
 4500.64	SMD Steckzungen	Messing	verzinkt reflow	gegurtet (à 500 Stk.)

Blistern von SMD Bauteilen

Im Zuge der zunehmend vollautomatisierten Bestückung von Leiterplatten haben wir das Angebot von SMD Teilen ausgebaut und den Bedürfnissen des Marktes angepasst. Diese Teile werden nach der Herstellung und Veredelung produktschonend in eine Sichtverpackung eingebracht.

www.vogt.ch



SMD

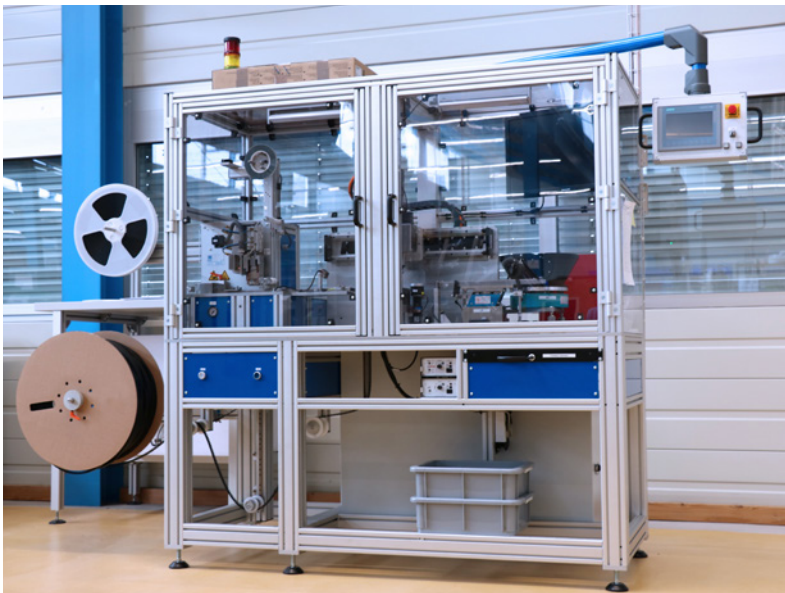
Rationelle und schonende Verarbeitung

SMD steht für Surface Mounted Devices, ein oberflächenmontiertes Bauelement einer Elektronikprintplatte. Besonders kleine Bauteile werden mit dieser Technologie schonend und rationell verarbeitet. Während bei der herkömmlichen Durchsteckmontage (THT, Through Hole Technology) mehrere Schritte notwendig sind, wird das SMD-Bauteil direkt auf eine kupferkaschierte Oberfläche der Platine platziert und verlötet.

Die direkte Oberflächenmontage ermöglicht eine beidseitige Verarbeitung und kann in kleinen, kompakten Baugehäusen, wie zum Beispiel in Handys oder medizinischen Geräten problemlos eingebaut werden. Mit dem Wegfall der Bohrung und der dadurch schnelleren Fertigung können zusätzlich Kosten eingespart werden.

Blistern

Neue Möglichkeiten



Bei der Vogt AG stehen diverse Blisterautomaten im Einsatz. Die neueste Maschinengeneration ermöglicht das maschinelle Verpacken von verschiedenen Grössen und auch kleineren Mengen. Im Bedarfsfall kann eine Kameraeinheit die korrekte Lage von unsymmetrischen Teilen prüfen.

